

公司代码：605358

公司简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经董事会审议通过的利润分配预案为：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为40,058万股，合计拟派发现金红利4,406.38万元（含税），剩余利润结转至以后年度分配。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分派总额，并将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	立昂微	605358	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴能云	任德孝
办公地址	杭州经济技术开发区20号大街199号	杭州经济技术开发区20号大街199号
电话	0571-86597238	0571-86597207
电子信箱	wny@li-on.com	rdx@li-on.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务主要分三大板块,分别是半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片。

主要产品包括 6-12 英寸半导体硅抛光片和硅外延片、6 英寸肖特基芯片和 MOSFET 芯片、6 英寸砷化镓微波射频芯片等三大类。产品的应用广泛，主要的应用领域包括通信、计算机、汽车、消费电子、光伏、智能电网、医疗电子以及 5G、物联网、工业控制、航空航天等产业。公司经过二十多年的发展，已经发展成为目前国内屈指可数的从硅片到芯片的一站式制造平台，形成了以盈利的小尺寸硅片产品带动大尺寸硅片的研发和产业化，以成熟的半导体硅片业务、半导体功率器件业务带动化合物半导体射频芯片产业的经营模式，很好的兼顾了企业的盈利能力及未来的发展潜力，为公司的持续、快速发展打下了坚实的基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	637,534.63	475,745.98	34.01	389,107.13
营业收入	150,201.78	119,168.60	26.04	122,266.70
归属于上市公司股东的净利润	20,195.77	12,818.79	57.55	18,075.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,019.28	8,579.38	75.06	15,534.20
归属于上市公司股东的净资产	185,532.86	151,390.24	22.55	143,611.45
经营活动产生的现金流量净额	30,997.34	38,333.01	-19.14	37,364.38
基本每股收益（元/股）	0.55	0.36	52.78	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.36	52.78	0.50
加权平均净资产收益率（%）	12.28	8.77	增加3.51个百分点	13.22

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	30,932.77	33,919.29	38,424.09	46,925.63
归属于上市公司股东的净利润	3,247.68	4,373.44	5,464.81	7,109.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	2,008.45	3,496.40	3,576.47	5,937.96

净利润				
经营活动产生的现金流量净额	2,420.17	3,731.76	-1,371.11	26,216.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

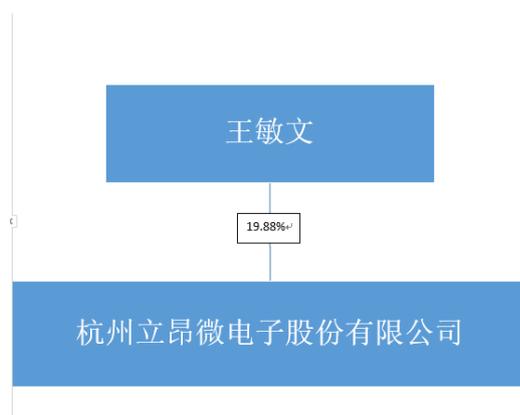
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		51,512					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		41,397					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
王敏文		79,615,720	19.88	79,615,720	无	0	境内 自然人
宁波利时信息科技有 限公司		27,332,500	6.82	27,332,500	质押	15,000,000	境内 非国 有法 人
仙游泓祥企业管理合 伙企业（有限合伙）		26,998,800	6.74	26,998,800	无	0	其他
国投创业投资管理有 限公司—国投高新 （深圳）创业投资基 金（有限合伙）		14,349,978	3.58	14,349,978	无	0	其他
韦中总		9,912,017	2.47	9,912,017	无	0	境内 自然 人
陈卫忠		9,550,688	2.38	9,550,688	无	0	境内 自然 人
王式跃		9,523,730	2.38	9,523,730	无	0	境内 自然 人
仙游泓万企业管理合 伙企业（有限合伙）		8,289,107	2.07	8,289,107	无	0	其他

贾银凤		8,194,165	2.05	8,194,165	无	0	境内自然人
陈茶花		7,401,823	1.85	7,401,823	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人王敏文持有泓万投资 55.16% 出资份额，持有泓祥投资 78.498% 出资份额，为一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

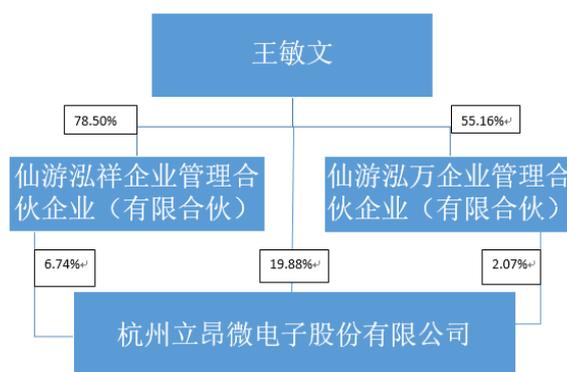
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

面对中美贸易摩擦加剧和全球复杂严峻的宏观环境，叠加全球经济增速放缓和“新冠肺炎”的压力，公司管理层在董事会的领导下，按照董事会制定的战略规划和经营计划，坚定不移践行“系统谋划，统筹配置、适时调整，满足需要”的总基调，充分发挥集团整体协同优势，积极应对市场变化，有效组织生产，加强内部控制管理，持续推进公司高质量发展。

2020 年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。经证监会核准，并经上交所同意，2020 年 9 月 11 日，公司正式登陆 A 股市场并上交所主板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,058.00 万股，证券代码“605358”，这也意味着公司成功进入资本市场，迈入新的发展阶段。

报告期内，公司实现营业收入 150,201.78 万元，较上年同期增长 26.04%；实现营业利润 23,915.55 万元，较上年同期增长 37.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,195.77 万元，较上年同期增长 57.55%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 15,019.28 万元，较上年同期增长 75.06%；经营活动产生的现金流量净额为 30,997.34 万元，较上年同期下降 19.14%。报告期末，公司总资产 637,534.63 万元，较期初增长 34.01%；总负债 386,265.28 万元，较期初增长 38.03%；归属于上市公司股东的净资产 185,532.86 万元，较期初增长 22.55%。

影响公司报告期经营业绩的主要因素有：

（1）行业景气度提升：随着疫情带来的宅经济增长，以及智能经济快速发展带动的下游需求持续增加，2020 年公司所处半导体行业市场景气度不断提升，到下半年可以用“火爆”来形容也不为过，加以国外疫情近乎失控的乱局导致了半导体产业加速向东亚特别是中国转移，公司产业链一体化优势与规模效应优势得以进一步发挥，市场占有率稳步攀升；

（2）市场需求旺盛：器件产品的应用端光伏新能源行业、新能源汽车行业市场景气度也有显著提升，对公司生产的高端器件产品的需求持续增加，虽然产能有较大提升，但仍难以满足市场的旺盛需求，供不应求态势明显，也直接抬升了市场占有率；

（3）产能储备超前：公司之前较早布局且完成了 6 英寸、8 英寸硅片新产线建设，实施了功率器件产线的产能技改提升，恰逢其时，较为充分地满足了不断趋热的市场需求，近期建成的 12 英寸硅片产线与射频芯片产线也迎来了较好的市场机遇，开始了商业化量产销售；

（4）管理成效显著：现有的半导体硅片、功率器件产线通过工艺技术创新、管理提升和精益

化生产，在技术改进、产品结构优化、良率提升和成本控制等方面成果显著，有效提升了产能与品质，与市场需求有较高的契合度；

2020年下半年半导体行业的市场需求形势出乎意料地旺盛，公司半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片三大板块的既有产能还是远远不能完全满足客户需求，有待进一步加快产能提升，消除产能瓶颈。

2020年，全球疫情下衍生的“宅经济”、“云办公”和线上教学催生了消费电子和医疗电子产品需求大幅增长，同时，随着5G、物联网、新能源汽车等产业的崛起，芯片市场需求较为强劲，进而带动了硅片的市场需求。SEMI在2021年2月发布的《硅晶圆产业年末分析报告》称，2020年全球硅晶圆出货面积总量达12,407百万平方英寸，相较2019年的11,810百万平方英寸增长5%，且接近2018年创下的历史纪录，总营收为111.7亿美元，与上年基本持平。在此趋势下，公司作为国内半导体硅片领域的龙头企业，牢牢把握行业上升的窗口期，在各尺寸硅片生产线产能偏紧情况下，通过产品结构优化、工艺技术革新、降低生产成本以及加快新产品研发等措施，进一步巩固了产品技术优势、规模优势，增强了市场竞争力，半导体硅片营收取得了较大幅度增长。

报告期内，6英寸硅片增速显著，得益于国内经济的快速增长以及清洁能源、新能源汽车等需求爆发性增长，同时，人工智能、电子化应用的场景越来越多，带动了对芯片、硅片的需求，公司6英寸硅片产线长期处于满负荷运转状态，特别是6英寸特殊规格的硅外延片更是供不应求。大尺寸硅片规模上量明显，其中公司8英寸硅片产线的产能充分释放；12英寸硅片在关键技术、产品质量以及客户供应上取得重大突破，已实现规模化生产销售，目前主要销售的产品包括抛光片测试片及外延片正片，同时正在持续开展客户送样验证工作，预计将在2021年底达到年产180万片规模的产能。

2020年全球光伏市场高速增长，新能源汽车业务也蒸蒸日上，这给公司的肖特基芯片、MOS芯片等功率器件业务的增长带来了极大的市场机遇。

报告期内，公司的平面肖特基产品作为传统主打的应用于光伏的产品，仍占有较大的市场份额，但随着沟槽产品取代平面产品的趋势加快，公司沟槽肖特基、MOS产品借助光伏需求的增长在下半年销量也迅猛增长。应用于消费电子、汽车电子的功率器件产品上半年生产、市场受限严重，下半年市场反转，需求前所未有的旺盛，公司肖特基芯片、MOS芯片的订单量远远超出了实际最大产能，特别是MOS芯片的产销出现了爆发式增长。

近年来，5G通讯和智能手机的发展带动了砷化镓射频芯片的推广应用，3D识别、人工智能、无人驾驶、高端平面显示等新技术和新产品也给砷化镓射频芯片带来更大的发展空间。据分析，

2019—2024 年，中国砷化镓器件市场复合年均增长率在 15%左右，快于全球市场同期增速，中国市场规模占全球比重将进一步提升。

报告期内，公司射频芯片业务较去年有了较大发展，在稳定核心客户的同时开发了新客户共计 30 多家，但目前产线单一机台较多，预期产能的发挥受到限制，长期处于供不应求状态，随着设备的填平补齐，预计 2021 年将会达到预期产能，有较大的产出与销售量。

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》的相关要求（以下简称新收入准则），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。具体内容详见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”中 44 “重要会计政策和会计估计的变更”。

3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

4 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

杭州立昂微电子股份有限公司

董事长：王敏文

2021 年 4 月 8 日